

**Sil-Pad 600®** est un élastomère de silicone thermiquement conducteur chargé d'ingrédients spéciaux pour assurer des propriétés thermiques supérieures à celles du Sil-Pad original à base de fibre de verre. Ce matériau présente d'excellentes caractéristiques physiques et mécaniques tout en restant économique. (Matériau électriquement isolant)

La famille **Sil-Pad 900-S®** de matériaux isolants thermiquement conducteurs est conçue pour les applications économiques nécessitant une résistance thermique élevée. Destinée à être une amélioration de l'alternative Sil-Pad 600.

**Q-Pad 3®** est un élastomère renforcé de fibres de verre et de graphite, thermiquement conducteur, qui épouse extrêmement bien les textures de surface. Ce matériau élimine les problèmes associés à la graisse thermique, tels que la pollution des ensembles électroniques et des bains de soudure par reflux. Q-Pad 3 peut être installé avant le soudage et le nettoyage. (Matériau conducteur de l'électricité)

**Sil-Pad K10®** est un film composite en Kapton thermiquement conducteur revêtu d'une résine de polyester renforcée de nitrure de bore, offrant les propriétés thermiques les plus élevées des isolants en Kapton avec une épaisseur minimum et une résistance thermique moindre. Conçu pour remplacer les isolants fragiles en céramique. (Matériau électriquement isolant)

**CPU Pad®** est une bande de Kapton double face, thermiquement conducteur, isolant électrique. Généralement utilisé entre l'unité centrale et le dissipateur de chaleur, il est conçu pour être utilisé à la place des pinces servant à fixer le dissipateur de chaleur sur l'unité centrale. Aucun temps de serrage ou de haute pression n'est nécessaire.

**SPT 400** est une isolation thermiquement conductrice pour les composants de puissance en plastique montés sur pince. Ces tubes thermiques TO-220 se glissent par-dessus le dispositif à semi-conducteur et évacuent la chaleur vers le dissipateur de chaleur et la pince. Conçus pour être utilisés sur les dissipateurs de chaleur avec des pinces en métal fixant le dispositif au dissipateur de chaleur. (Matériau électriquement isolant)

**HI-FLOW™ 115-AC** est un matériau à changement de phase thermiquement

conducteur, renforcé de fibres. Le produit comprend un composé thermiquement conducteur à changement de phase à 65 °C enrobant un tissu de fibre de verre avec un revêtement adhésif d'un côté pour fixation sur un dissipateur de chaleur froid. Se comporte comme Sil-Pad à température ambiante et s'écoule comme une graisse de haute qualité à température élevée.

**Bond Ply™ 100** est une bande adhésive thermiquement conductrice, double face, sensible à la pression. La bande se compose d'un adhésif acrylique haute performance, thermiquement conducteur, enrobant un maillage renforcé de fibre de verre. Bond Ply 100 est conçu pour présenter une adhérence élevée sur une grande variété de surfaces et pour maintenir une forte adhésion après une exposition à long terme à une chaleur modérée et à une humidité élevée. Applications typiques : • Montage d'un dissipateur de chaleur sur un processeur graphique BGA • Montage d'un dissipateur de chaleur sur un processeur d'ordinateur • Montage d'un dissipateur de chaleur sur un processeur de lecteur • Montage d'un dissipateur de chaleur sur un circuit imprimé de convertisseur de puissance • Montage d'un dissipateur de chaleur sur un circuit imprimé de commande de moteur.

**Gap Pad™ 1500** est conçu pour optimiser de manière économique le transfert de chaleur de composants électroniques aux dissipateurs de chaleur. GP 1500 est un matériau fortement déformable à faible module qui remplit les espaces d'air causés par les décalages, les surfaces rugueuses et les fortes tolérances d'empilage. Sa souplesse relâche les contraintes et absorbe les chocs en minimisant les dommages des fils délicats. GP 1500 est un matériau électriquement isolant qui peut être utilisé dans les applications nécessitant une isolation entre les dissipateurs de chaleur et les dispositifs à haute tension, aux conducteurs nus.

**Gap Pad™ 1500R** comporte le même polymère modulaire très conforme que le Gap Pad™1500 standard. Le renforcement en fibre de verre permet une manipulation facile du matériau et améliore la résistance aux perforations, ruptures et déchirures. La nature collante des deux faces du matériau permet une bonne adhérence aux surfaces de contact des composants, ce qui réduit davantage la résistance thermique.

**Sil-Pad K-4®** utilise un film spécialement développé présentant une forte conductivité thermique, une force diélectrique élevée, et est très robuste. Sil-Pad K-4 combine les propriétés de transfert thermique du caoutchouc Sil-Pad bien connu aux propriétés physiques d'un film. Sil-Pad K-4 est un isolant robuste supportant de fortes tensions et ne nécessitant pas de graisse thermique pour transférer la chaleur.

**Sil-Pad K-6®** est un isolant thermiquement conducteur de performance moyenne à base de film. Le film est enduit d'un élastomère de silicone pour fournir des performances élevées et assure une barrière diélectrique continue physiquement robuste contre les coupures et les défaillances d'ensemble qui en résultent.

**Sil-Pad 1000®** présente les mêmes caractéristiques mécaniques et physiques que notre matériau Sil-Pad 400 tout en offrant une réduction de 35 % de la résistance thermique. Sil-Pad 1000 est un composé de caoutchouc siliconé et de fibre de verre. Il est spécialement chargé et offre une faible résistance thermique. Sil-Pad 1000 est non toxique et résiste aux dommages des agents de nettoyage. Il est ignifugé et formulé spécialement pour être utilisé comme isolant thermiquement conducteur.

**Sil-Pad 2000®** est l'isolant thermiquement conducteur à haute fiabilité et à hautes performances de Bergquist. Sil-Pad 2000 est conçu pour les applications militaires/aérospatiales et commerciales exigeantes. Dans ces applications, Sil-Pad 2000 est conforme aux normes militaires. Cet élastomère siliconé est spécialement rempli pour optimiser les performances thermique et diélectrique de la matrice de matière de charge/liant. Le résultat est un matériau conforme, sans graisse, répondant aux exigences thermiques et électriques des applications de conditionnement électronique de grande fiabilité ou des dépassants.

**Gap-Pad® VO Ultra doux** est recommandé pour les applications à contraintes extrêmement basses. La nature visco-élastique du matériau assure également des caractéristiques excellentes d'amortissement sous faibles contraintes et d'absorption des chocs. Gap Pad VO Ultra doux est un matériau électriquement isolant qui peut être utilisé dans les applications nécessitant une isolation entre les dissipateurs de chaleur et les composants haute tension aux fils dénudés.

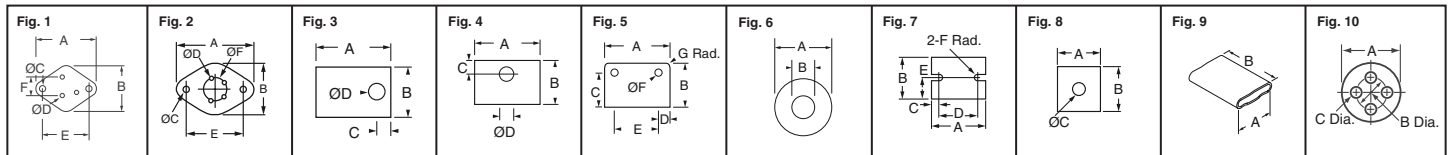


Fig.	Type d'appareil	Dimensions – pouces (mm)							N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence Bergquist	
		A	B	C	D	E	F	G		1	10	50	100		
1	TO-3	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER100-ND	.92	.83	.74	.66	SP600-05	
		1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER172-ND	.92	.83	.74	.66	SP900S-05	
		1.78 (45.21)	1.25 (31.75)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER101-ND	.99	.89	.80	.71	SP600-02	
		1.78 (45.21)	1.25 (31.75)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER171-ND	.90	.80	.72	.64	SP900S-02	
		1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER111-ND	1.97	1.76	1.58	1.40	K10-05	
		1.78 (45.21)	1.25 (31.75)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER112-ND	2.20	1.97	1.77	1.57	K10-02	
	TO-3 / TO-66	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER122-ND	.60	.54	.48	.43	Q3-05	
		1.250 (31.75)	.700 (17.78)	.140 (3.56)	.062 (1.57)	.960 (24.38)	.200 (5.08)	—	BER152-ND	.87	.79	.71	.62	K10-30	
		1.78 (45.21)	1.25 (31.75)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER209-ND*	.53	.48	.43	.38	7403-09FR-02	
		1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER203-ND*	.51	.46	.41	.37	3223-07FR-05	
		1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER212-ND*	.51	.46	.41	.37	7403-09FR-05	
		1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.122 (3.10)	.062 (1.57)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER211-ND*	.51	.46	.41	.37	7403-09FR-04	
2	TO-3 (4PIN)	1.56 (39.62)	1.05 (26.67)	.156 (39.62)	.080 (2.03)	1.170 (29.72)	.470 (11.94)	—	BER210-ND*	.49	.44	.40	.35	7403-09FR-03	
		1.56 (39.62)	1.05 (26.67)	.156 (39.62)	.080 (2.03)	1.170 (29.72)	.470 (11.94)	—	BER218-ND*	.45	.41	.37	.32	7403-09FR-11	
		1.56 (39.62)	1.05 (26.67)	.156 (39.62)	.080 (2.03)	1.170 (29.72)	.470 (11.94)	—	BER139-ND	.61	.56	.50	.44	SP600-86	
		1.56 (39.62)	1.05 (26.67)	.156 (39.62)	.080 (2.03)	1.170 (29.72)	.470 (11.94)	—	BER140-ND	1.26	1.13	1.01	.90	K10-86	
		1.56 (39.62)	1.05 (26.67)	.156 (39.62)	.080 (2.03)	1.170 (29.72)	.470 (11.94)	—	BER141-ND	.42	.38	.34	.30	Q3-86	
		1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER178-ND	.69	.63	.56	.50	SP900S-104	
	3	TO-247AC	1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER120-ND	1.15	1.03	.93	.82	K10-104
			1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER131-ND	.53	.48	.43	.38	Q3-104
			1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER200-ND	1.42	1.28	1.15	1.01	2015-104
			1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER204-ND*	.43	.39	.35	.31	3223-07FR-104
			1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER221-ND	.56	.51	.45	.40	K6-104
			1.00 (25.40)	.750 (19.05)	.300 (7.62)	.140 (3.56)	—	—	—	BER109-ND	.53	.48	.43	.38	SP600-104
TO-220		.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER208-ND*	.61	.55	.50	.44	3223-07FR-90	
		.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER217-ND*	.42	.38	.34	.30	7403-09FR-90	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	—	—	—	—	—	BER102-ND	.62	.56	.50	.44	SP600-58	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER176-ND	.62	.56	.50	.44	SP900S-58	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER103-ND	.62	.56	.50	.44	SP600-54	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER175-ND	.62	.56	.50	.44	SP900S-54	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	—	—	—	—	—	BER110-ND	.62	.56	.50	.44	SP600-43	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	—	—	—	—	—	BER174-ND	.62	.56	.50	.44	SP900S-43	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER113-ND	.86	.78	.70	.62	K10-58	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER114-ND	.69	.63	.56	.50	K10-54	
		.750 (19.05)	.500 (12.70)	—	—	—	—	—	BER121-ND	.86	.78	.70	.62	K10-43	
		4	MULTI	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER124-ND	.51	.46	.41	.37
.750 (19.05)	.500 (12.70)			.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER125-ND	.51	.46	.41	.37	Q3-54	
.750 (19.05)	.500 (12.70)			.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER198-ND	.48	.43	.39	.34	1009-54	
.750 (19.05)	.500 (12.70)			.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER201-ND	.91	.81	.73	.65	2015-54	
.750 (19.05)	.500 (12.70)			.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER206-ND*	.13	.12	.11	.09	3223-07FR-54	
.750 (19.05)	.500 (12.70)			.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER215-ND*	.41	.37	.33	.29	7403-09FR-54	
SIP	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER219-ND	.54	.49	.44	.39	K4-54	
	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER199-ND	.48	.43	.39	.34	1009-58	
	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER202-ND	.91	.81	.73	.65	2015-58	
	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER207-ND*	.48	.44	.39	.35	3223-07FR-58	
	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER216-ND*	.41	.37	.33	.29	7403-09FR-58	
	.750 (19.05)		.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER220-ND	.46	.41	.37	.33	K4-58	
5	SIP	.750 (19.05)	.500 (12.70)	—	—	—	—	—	BER132-ND	.51	.46	.41	.37	Q3-43	
		.687 (17.45)	.562 (14.27)	.218 (5.54)	.125 (3.18)	—	—	—	BER205-ND*	.41	.37	.33	.29	3223-07FR-51	
		.687 (17.45)	.562 (14.27)	.218 (5.54)	.125 (3.18)	—	—	—	BER214-ND*	.41	.37	.33	.29	7403-09FR-51	
		.687 (17.45)	.562 (14.27)	.218 (5.54)	.125 (3.18)	—	—	—	BER146-ND	.61	.55	.50	.44	K10-51	
		.687 (17.45)	.562 (14.27)	.218 (5.54)	.125 (3.18)	—	—	—	BER147-ND	.36	.33	.30	.26	Q3-51	
		.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER108-ND	.68	.61	.54	.48	SP600-90	
6	DO-5	.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER177-ND	.68	.61	.54	.48	SP900S-90	
		.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER119-ND	1.07	.95	.86	.76	K10-90	
		.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER130-ND	.53	.47	.43	.38	Q3-90	
		.945 (24.00)	.827 (21.01)	.196 (4.98)	.150 (3.81)	—	—	—	BER107-ND	.70	.63	.57	.50	SP600-114	
		.945 (24.00)	.827 (21.01)	.196 (4.98)	.150 (3.81)	—	—	—	BER180-ND	.70	.63	.57	.50	SP900S-114	
		.945 (24.00)	.827 (21.01)	.196 (4.98)	.150 (3.81)	—	—	—	BER118-ND	1.17	1.05	.94	.83	K10-114	
7	Module SIP	1.450 (36.83)	.838 (21.29)	.612 (15.54)	.245 (6.22)	.960 (24.38)	.170 (4.32)	.120 (3.05)	BER106-ND	.80	.71	.64	.57	SP600-105	
		1.450 (36.83)	.838 (21.29)	.612 (15.54)	.245 (6.22)	.960 (24.38)	.170 (4.32)	.120 (3.05)	BER117-ND	1.49	1.34	1.20	1.06	K10-105	
		1.450 (36.83)	.838 (21.29)	.612 (15.54)	.245 (6.22)	.960 (24.38)	.170 (4.32)	.120 (3.05)	BER179-ND	.80	.71	.64	.57	SP900S-105	
		1.00 (25.40)	.260 (6.60)	—	—	—	—	—	BER105-ND	.75	.67	.60	.53	SP600-25	
		1.00 (25.40)	.260 (6.60)	—	—	—	—	—	BER173-ND	.75	.67	.60	.53	SP900S-25	



Fig.	Type d'appareil	Dimensions - pouces (mm)							N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence Bergquist
		A	B	C	D	E	F	G		1	10	50	100	
8	CPU	.63 (16.00)	.63 (16.00)	—	—	—	—	—	BER133-ND	.44	.40	.36	.32	CPU 63X.63
		1.375 (34.93)	1.375 (34.93)	—	—	—	—	—	BER135-ND	.73	.66	.59	.52	CPU 1.375X1.375
	Pont redresseur	1.00 (25.40)	1.00 (25.40)	.187 (4.75)	—	—	—	—	BER142-ND	.39	.35	.32	.28	Q3-48
		1.25 (31.75)	1.25 (31.75)	.200 (5.08)	—	—	—	—	BER144-ND	.42	.37	.34	.30	Q3-46
9	Tubes TO-220	.433 (11.00)	.985 (25.02)	—	—	—	—	BER145-ND	1.22	1.09	.98	.87	K10-46	
	Tubes TO-247	.532 (13.50)	.985 (25.02)	—	—	—	—	BER156-ND	.62	.56	.50	.44	SPT400-12-11-25	
10	TO-5	.360 (9.14)	.200 (5.08)	.040 (1.02)	—	—	—	BER157-ND	.75	.68	.61	.54	SPT400-12-13.5-25	
<b>Pastilles « Hi-Flow™ » à support adhésif simple face (à changement de phase)</b>														
1	TO-3	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER161-ND	.24	.21	.19	.17	HF115TAAC-05
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER167-ND	.09	.08	.07	.06	HF115TAAC-54
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER168-ND	.09	.08	.07	.06	HF115TAAC-58
3	TO-218	.860 (21.84)	.740 (18.80)	.200 (5.08)	.160 (4.06)	—	—	—	BER169-ND	.10	.09	.08	.07	HF115TAAC-90
5	SIP	1.450 (36.83)	.830 (21.08)	.612 (15.54)	.245 (6.22)	.960 (24.38)	.170 (4.32)	.120 (3.05)	BER170-ND	.12	.11	.10	.09	HF115TAAC-105
<b>Pastilles « SP900 » à support adhésif simple face (à faible pression de montage)</b>														
1	TO-3	1.65 (41.91)	1.14 (28.96)	.140 (3.56)	.093 (2.36)	1.187 (30.15)	.430 (10.92)	—	BER181-ND	.97	.87	.78	.69	SP900EAAC-05
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.147 (3.73)	—	—	—	BER182-ND	.63	.57	.51	.45	SP900EAAC-54
3	TO-220	.750 (19.05)	.500 (12.70)	.187 (4.75)	.125 (3.18)	—	—	—	BER183-ND	.63	.57	.51	.45	SP900EAAC-58
<b>Bande thermique double face « Bond Ply™ 100 »</b>														
Pastille thermique adhésive double face, 0,005" (0,127 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 11" x 12" (27,94 x 30,48 cm)									BER246-ND	35.10	31.32	28.08	24.84	BOND PLY 105 11x12"
Pastille thermique adhésive double face, 0,008" (0,203 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 10" (25,4 cm)									BER159-ND	43.19	38.54	34.56	30.57	BOND PLY 108 10x10"
Pastille thermique adhésive double face, 0,011" (0,279 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 10" (25,4 cm)									BER160-ND	54.01	48.20	43.21	38.23	BOND PLY 111 10x10"
<b>Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ 1500 »</b>														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER161-ND	8.45	7.55	6.77	5.99	.020 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER162-ND	12.14	10.84	9.72	8.60	.040 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER163-ND	13.93	12.43	11.15	9.86	.060 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER164-ND	16.47	14.69	13.17	11.65	.080 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille carrée de 4" (10,16 cm)									BER165-ND	22.35	19.95	17.89	15.82	.125 GP 1500 4" X 4"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER227-ND	83.88	74.85	67.11	59.36	.040 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER228-ND	82.03	73.20	65.63	58.06	.060 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER229-ND	93.95	83.84	75.17	66.49	.080 GP 1500 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER230-ND	160.35	143.08	128.28	113.48	.125 GP 1500 8" X 16"
<b>Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ 1500R »</b>														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,010" (0,254 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER231-ND	45.92	40.98	36.74	32.50	GP1500R 10 MIL 8" x 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,015" (0,381 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER232-ND	56.24	50.19	45.00	39.80	GP1500R 15 MIL 8" x 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER233-ND	61.80	55.15	49.44	43.74	GP1500R 20 MIL 8" x 16"
<b>Matériau de remplissage thermique « Gap Pad™ VO Ultra doux »</b>														
Pastille à haute conductivité thermique, 0,020" (0,508 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER222-ND	61.03	54.46	48.83	43.19	.020 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,040" (1,02 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER223-ND	76.75	68.49	61.40	54.32	.040 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,060" (1,52 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER224-ND	86.11	76.84	68.89	60.94	.060 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,080" (2,03 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER225-ND	98.66	88.04	78.93	69.82	.080 GP US 8" X 16"
Pastille à haute conductivité thermique, 0,125" (3,18 mm) d'épaisseur, feuille de 8 x 16" (20,32 x 40,64 cm)									BER226-ND	163.79	146.15	131.04	115.92	.125 GP US 8" X 16"

\* En matériau SP400

C

**KEYSTONE**

**Isolateurs en MICA pour montage de transistor**

Ces isolateurs en MICA estampés avec précision assurent une bonne conductivité thermique (0,009 Watts par pouce carré par °C par pouce d'épaisseur). Excellente résistance thermique 1 100 °F (593 °C). Constante diélectrique de 7 à 1 000 kHz.

**Spécifications :** MICA de 0,003" (0,08 mm) d'épaisseur ± 0,001" (± 0,03 mm).

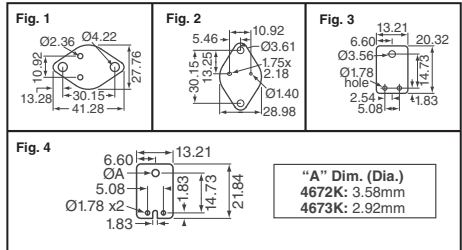
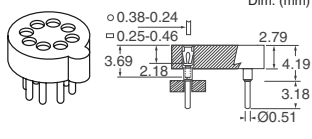


Fig.	N° de référence Digi-Key	10	100	Prix 500	1 000	N° de référence Keystone
1	4651K-ND	1.09	9.56	32.47	44.00	4651
2	4662K-ND	1.19	10.29	34.07	48.16	4662
3	4671K-ND	1.15	9.56	32.47	23.28	4671
4	4672K-ND	1.01	9.56	32.47	18.02	4672
4	4673K-ND	1.01	9.56	32.47	18.02	4673

**MILL-MAX**

**Supports de transistor**

**Placage :**  
 Douille (broche) : 200 µm  
 Sn/Pb (conforme à RoHS) : 200 µm Sn ; Contact (pinces) : 30 µm Au



Nb de broches	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Mill-Max
<b>Boîtier TO-5</b>					
3	ED2150-ND	1.09	.93	.76	917-93-103-41-005000
3	ED90273-ND	1.50	1.27	1.04	917-43-103-41-005000
4	ED2151-ND	1.18	1.00	.82	917-93-104-41-005000
4	ED90274-ND	1.58	1.35	1.10	917-43-104-41-005000
8	ED2152-ND	1.52	1.30	1.06	917-93-108-41-005000
8	ED90275-ND	1.95	1.65	1.35	917-43-108-41-005000
<b>Boîtier TO-100</b>					
8	ED2153-ND	1.52	1.30	1.06	917-93-208-41-005000
8	ED90276-ND	1.95	1.65	1.35	917-43-208-41-005000
10	ED2154-ND	2.24	1.90	1.55	917-93-210-41-005000
10	ED90277-ND	2.35	2.00	1.63	917-43-210-41-005000

◆ Conforme à RoHS

**KEYSTONE**

**Supports de transistor de puissance TO-3**

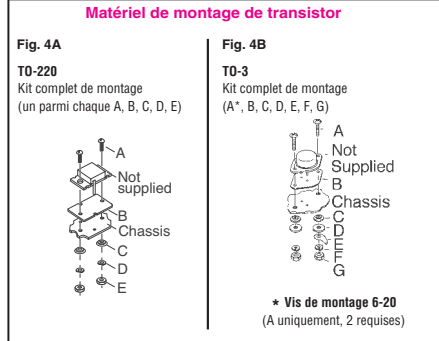
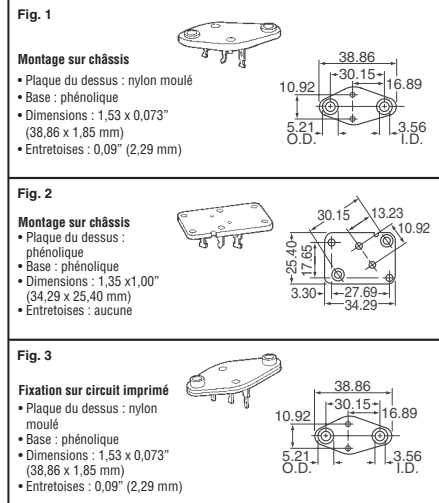


Fig.	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Keystone
1	4601K-ND	2.09	1.97	1.89	4601
2	4606K-ND	1.79	1.68	1.47	4606
3	4600K-ND	1.86	1.76	1.60	4600
4A	4724K-ND	1.79	1.66	1.47	4724
4B	4725K-ND	1.79	1.66	1.47	4725
4B	4706K-ND*	2.45/20	23.23/200		4706

**ASAHI RUBBER INC.**

**Pastilles de dissipateur de chaleur**

Asahi Rubber offre un produit excellent pour les applications nécessitant une solution thermique. La série ART est un gel de silicone thermiquement conducteur pouvant être coupé à la demande.

**Caractéristique :**  
 • Couleur : gris • Dimensions : 11,81 x 8,46" (300 x 215 mm) • Plaque d'épaisseurs : 0,3 à 2,0 mm • Plage de températures de fonctionnement : -60 à 200 °C

Épaisseur pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	1	10	50	N° de réf. Asahi
.01 (0.3)	509-1000-ND	40.76	37.37	33.29	ART03
.02 (0.5)	509-1001-ND	44.90	41.16	36.67	ART05
.04 (1.0)	509-1002-ND	64.87	59.47	52.98	ART10
.06 (1.5)	509-1003-ND	83.17	76.24	67.92	ART15
.08 (2.0)	509-1004-ND	101.74	93.27	83.09	ART20

**molex**

**Supports de transistor TO-220 à patte de soudure**

**Montage sur CI :** 0,100" (2,54 mm) centre. Ces trois supports de transistor sont préassemblés et prêts à être soudés sur un circuit imprimé. Le modèle éprouvé à double porte-à-faux élimine les déformations de circuit causées par l'expansion thermique et les tolérances mécaniques.

Le mouvement linéaire des fils de transistor dans le support n'affecte pas la fiabilité du contact.

**Matériau :** laiton étamé, nylon 94V-2

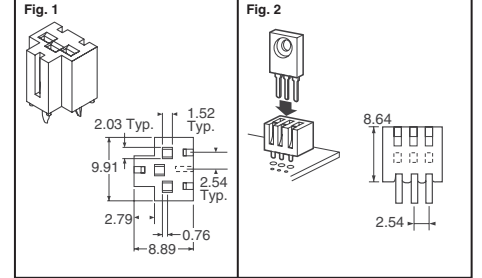


Fig.	N° de référence Digi-Key	1	10	100	N° de référence Molex
1	WM2550-ND	1.19	1.13	1.03	09-48-3031
2	WM2551-ND	1.56	1.47	1.34	10-18-2031